

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호

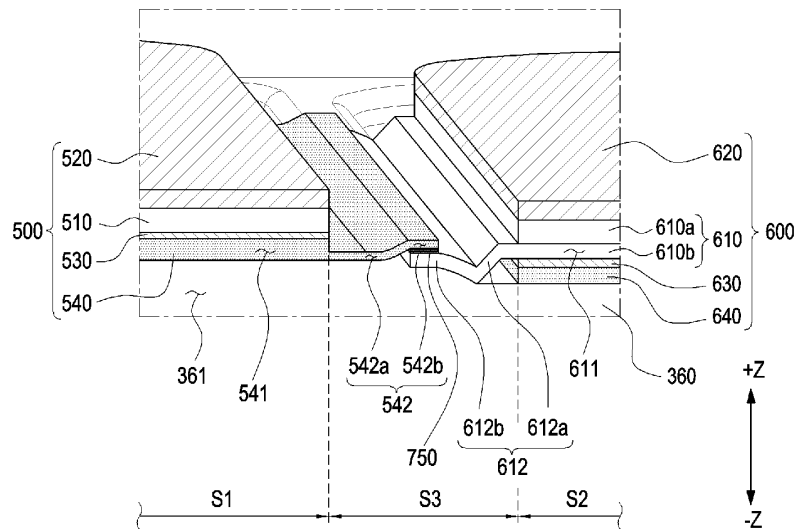
WO 2022/215873 A1

2022 년 10 월 13 일 (13.10.2022) WIPO | PCT

- (51) 국제특허분류:
H05K 7/20 (2006.01) H01Q 1/24 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01) H02J 50/10 (2016.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/003258
- (22) 국제출원일: 2022 년 3 월 8 일 (08.03.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2021-0044838 2021 년 4 월 6 일 (06.04.2021) KR
- (71) 출원인: 삼성전자 주식회사 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) [KR/KR]; 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 김용연 (KIM, Yongyoun); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 오찬희 (OH, Chanhee); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 경동기 (JUNG, Dongkee); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 이견주 등 (LEE, Keon-Joo et al.); 03079 서울시 종로구 대학로9길 16 미화빌딩, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE,

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE INCLUDING HEAT DISSIPATION STRUCTURE

(54) 발명의 명칭: 방열 구조를 포함하는 전자 장치



(57) Abstract: An electronic device according to various embodiments of the present disclosure may include: a housing, a non-conductive support member disposed inside the housing, the support member including a first area, a second area spaced apart from the first area, and a third area connecting the first area and the second area; a conductive pattern part disposed over the first area of the support member; a heat dissipation member of which at least a part is disposed to overlap the conductive pattern part; and an antenna including a circuit board, a conductive portion, and a ground portion. The conductive portion of the antenna may be disposed over the second area, the heat dissipation member may be formed to extend from the first area to the third area, and the ground portion of the antenna may be formed to extend from the second area to the third area so as to be disposed in contact with at least a part of the heat dissipation member.

[다음 쪽 계속]

WO 2022/215873 A1

LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(57) 요약서: 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 하우스징, 상기 하우스징 내부에 배치된 비도전성 지지 부재로서, 제1 영역, 상기 제1 영역과 이격된 제2 영역, 및 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역을 연결하는 제3 영역을 포함하는 지지 부재, 상기 지지 부재의 상기 제1 영역 위(over)에 배치된 도전성 패턴부, 적어도 일부가 상기 도전성 패턴부와 중첩 배치된 방열 부재, 및 회로기판, 도전성 부분, 및 그라운드 부분을 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 상기 안테나의 상기 도전성 부분은 상기 제2 영역 위에 배치되고, 상기 방열 부재는 상기 제1 영역으로부터 상기 제3 영역으로 연장 형성되고, 상기 안테나의 상기 그라운드 부분은 상기 제2 영역으로부터 상기 제3 영역으로 연장 형성되어 상기 방열 부재의 적어도 일부와 접촉 배치될 수 있다.